

S1D14F57 マニュアル 正誤表

項目 出荷形態			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1D14F57 テクニカルマニュアル	412355401	2. 特徴	2
(誤) 出荷形態 : アルミパッドチップ 金バンプチップ			
(正) 出荷形態 : 金バンプチップ			

S1D14F57 マニュアル 正誤表

項目 チップ厚、バンプ厚み			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1D14F57 テクニカルマニュアル	412355401	4.1 チップ情報 表 4.1 チップ仕様	4

(誤)

項目		サイズ		単位
		X	Y	
チップサイズ		16.0	1.0	mm
チップ厚		200 / 300/ 400		μm
パッド開口部	No. 2~144, 147~342	70	96	μm
	No.1,145,146,343	66	96	μm
最小バンプピッチ		80		μm
バンプサイズ	No. 2~144, 147~342	58	84	μm
	No.1,145,146,343	54	84	μm
バンプ高さ		15		μm
バンプ総面積		1669752		μm ²

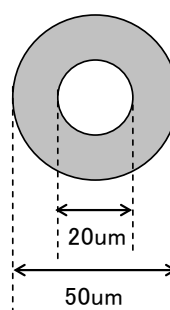
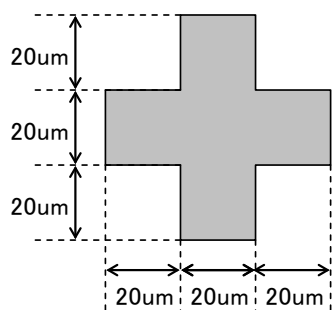
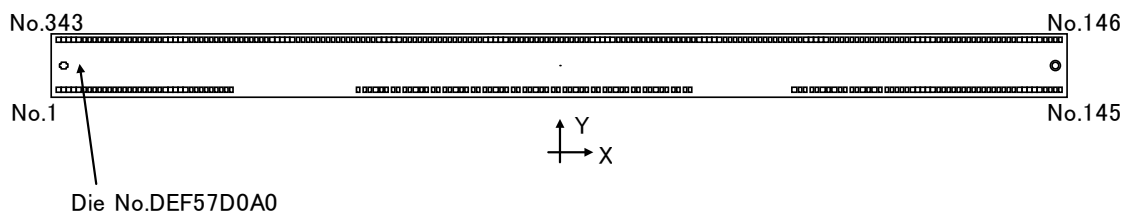
(正)

項目		サイズ		単位
		X	Y	
チップサイズ		16.0	1.0	mm
チップ厚		300		μm
パッド開口部	No. 2~144, 147~342	70	96	μm
	No.1,145,146,343	66	96	μm
最小バンプピッチ		80		μm
バンプサイズ	No. 2~144, 147~342	58	84	μm
	No.1,145,146,343	54	84	μm
バンプ高さ		17±4		μm
バンプ総面積		1669752		μm ²

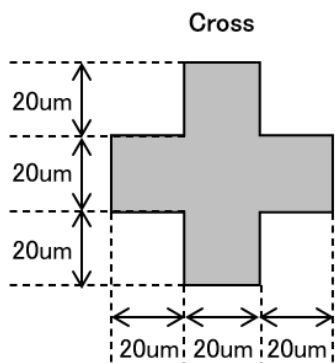
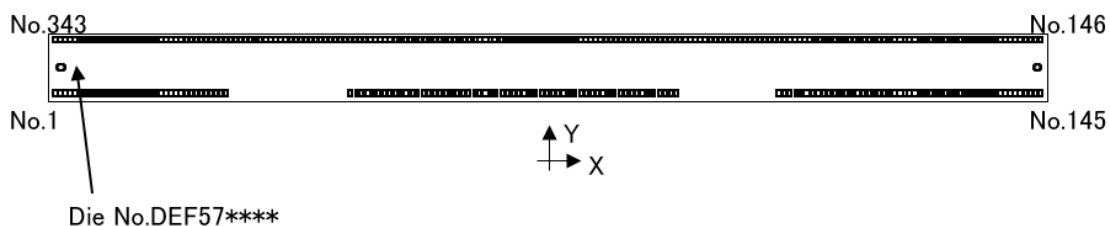
S1D14F57 マニュアル 正誤表

項目 チップ外形図			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1D14F57 テクニカルマニュアル	412355401	4.1 チップ情報 図 4.1 チップ外形図	4

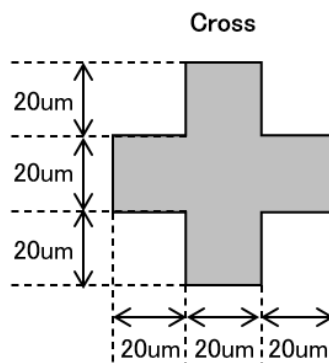
(誤)



(正)



(X = -7785.0um, Y = 50.0um)



(X = 7785.0um, Y = 50.0um)